

DTT65-s

低密度熱伝導シート

LiPOLY DTT65-s は、ネットワーク通信用途向けに設計された柔らかい熱伝導性ゲルパッドです。DTT65-s は、低D_k・低D_f特性により、RFモジュールへの干渉を低減します。DTT65-s の熱伝導率は5.0 W/m・K です。カットやパンチングなどのカスタマイズも可能で、より幅広くご使用いただけます。

■ 製品の特性

/ 軽量・低密度
/ 熱伝導率：5.0 W/m・K
/ 硬度：Shore OO/55
/ 低誘電率
/ 高周波用途に対応
/ 各種厚さに対応可能

■ 製品アプリケーション

/ 5G移動通信機器
/ 通信衛星装置
/ 衛星測位装置
/ ルーター
/ 通信設備
/ 5Gの基地局(基幹施設/設備)
/ 電気自動車

■ 製品の形

/ シート状
/ フォーミング形



■ 代表特性

物理特性	DTT65-s	単位	試験方法
色	Pink	-	Visual
表面粘着性 (2面 / 1面)	2	-	-
厚さ	Customized	mm	ASTM D374
密度	2.1	g/cm ³	ASTM D792
硬さ	55	Shore OO	ASTM D2240
吸水率	0.005	%	ASTM D570
使用温度	-60~180	°C	-
ROHS & REACH	Compliant	-	-
圧縮特性@1.0mm			
圧縮率@10 psi	8	%	ASTM D5470 modify
圧縮率@20 psi	11	%	ASTM D5470 modify
圧縮率@30 psi	16	%	ASTM D5470 modify
圧縮率@40 psi	21	%	ASTM D5470 modify
圧縮率@50 psi	26	%	ASTM D5470 modify
電気特性			
絶縁破壊電圧	10	KV/mm	ASTM D149
表面抵抗率	>10 ¹²	Ohm	ASTM D257
体積抵抗率	>10 ¹³	Ohm-m	ASTM D257
誘電率@2GHz D _k	4.131	-	ASTM D150
誘電率@6GHz D _k	4.058	-	ASTM D150
誘電率@10GHz D _k	4.013	-	ASTM D150
誘電正接@2GHz D _f	0.00509	-	ASTM D150
誘電正接@6GHz D _f	0.00658	-	ASTM D150
誘電正接@10GHz D _f	0.00780	-	ASTM D150
熱特性			
熱伝導率	5.0	W/m・K	ASTM D5470
熱抵抗@10 psi	0.350	°C-in ² / W	ASTM D5470
熱抵抗@20 psi	0.342	°C-in ² / W	ASTM D5470
熱抵抗@30 psi	0.323	°C-in ² / W	ASTM D5470
熱抵抗@40 psi	0.302	°C-in ² / W	ASTM D5470
熱抵抗@50 psi	0.281	°C-in ² / W	ASTM D5470

熱抵抗 vs. 圧力 vs. 圧縮率

